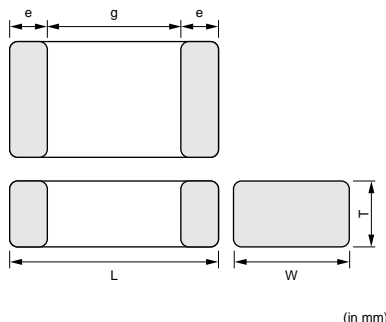


積層セラミックコンデンサ

GRM32EF10J107ZE20□ (3225, F, 100 μF, 6.3Vdc)

□は包装仕様コードが入ります。

RoHS指令対応品



(in mm)

外形寸法

L寸法	3.2mm ± 0.3mm
W寸法	2.5mm ± 0.2mm
T寸法	2.5mm ± 0.2mm
外部電極幅e	0.3mm以上
外部電極間距離g (以上)	1.0mm

包装仕様

コード	包装仕様	最小受注単位数
L	180mmエンボステーピング	1000
K	330mmエンボステーピング	4000
B	バラ袋	1000

定格値

	品番コード	規格値
温度特性(準拠規格)	F1	F (JIS), +30/-80%
静電容量	107	100 μF
静電容量許容差	Z	+80/-20%
定格電圧	0J	6.3Vdc

性能

PDFファイル
「GRMシリーズ性能および試験方法 (2)」
をご参照ください。

当データシートは、一般電子機器に使用されるめっきタイプチップ積層セラミックコンデンサに適用します。

「使用上の注意」

外部電極すず(Sn)めっき品の場合、すず(Sn)の融点より低い温度ではんだ付けを行うと、外部電極へのはんだ濡れ性が低下し、はんだ付け不良の原因となる場合があります。かならず実装評価を実施して、はんだ付け性をご確認ください。
Sn-Zn系はんだは、チップ積層セラミックコンデンサの信頼性に悪影響を与えます。Sn-Zn系はんだをご使用される際は、事前に当社までご連絡ください。

- ・「RoHS指令対応」とは、EU指令DIRECTIVE2002/95/ECに基づいて判断し、規制対象外と自然界に存在するレベルの不純物を除き、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDEを含有しないことを指します。
- ・この対応状況は、RoHS指令を受けて整備されるEUの各加盟国の法令への適合を保証するものではありません。

④お願い

1. 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2. 当データシートには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

2009.7.2